

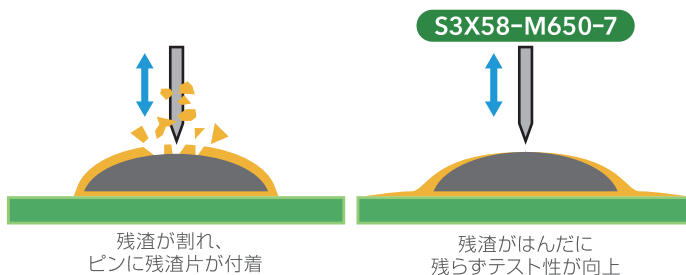
ICT性要求への対応と、枕不良、ボイド発生を同時に実現

## ハロゲンフリーソルダペースト

### ピンへのフラックス残渣付着を防止

はんだ上にフラックス残渣が厚く残っていると導通を妨げることがあり、基板に全く不良が無くても不良の判定が出る場合があります。**S3X58-M650-7**でははんだ溶融時のフラックスの流れを良好に保ち、はんだ上にフラックス残渣を残しません。また、フラックス残渣の粘着性を抑えて、ピンへの付着を防ぎます。

### ICT検査不具合例

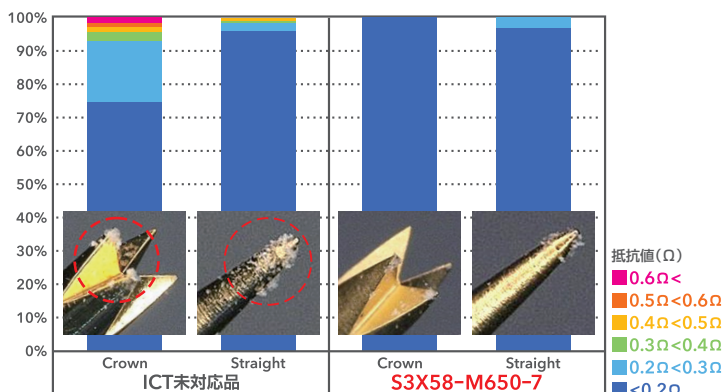
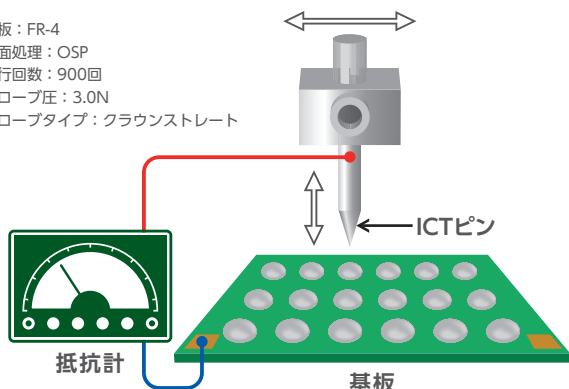


### チェッカーピンコンタクト性を大幅改善

ピンが確実にはんだに接触するほか、残渣片の付着が少なく、高い測定精度が得られます。

### チェッカーピンコンタクト性試験

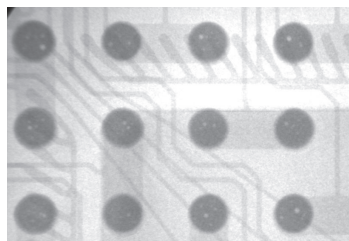
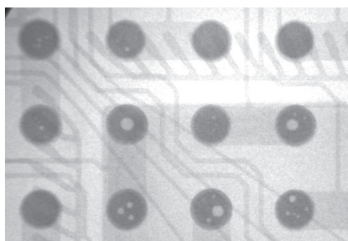
- 基板：FR-4
- 表面処理：OSP
- 試行回数：900回
- プローブ圧：3.0N
- プローブタイプ：クラウンストレート



### 高い溶解性でボイド発生を抑制

ICT未対応品

S3X58-M650-7



### 環境にやさしい完全ハロゲンフリー

### ハロゲン測定データ

● 試験条件：BS EN14582 ※外部機関にて測定

元素	検出量
Cl	不検出
Br	不検出
F	不検出
I	不検出

ハロゲン含有量 (ppm)

### 製品物性表

製品名	S3X58-M650-7
合金組成 (%)	Sn 3.0Ag 0.5Cu
融点 (°C)	217-219
粉末粒度 (μm)	20-38
粘度 (Pa·s)	200
フラックス含有量 (%)	11.5
ハライド含有量 (%)	0
フラックスタイプ	ROLO

ICTテスト対応	ハロゲンフリー
枕不良防止	低ボイド
ファインターン 0.4mmピッチ CSP>0.3mmφ	タック時間 >48時間
無洗浄タイプ	No-clean